

〈オンライン開催〉

「カーボンニュートラル実現に向けた熱設計 -高放熱機構と半導体パッケージモデル-」

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は、当協会の諸事業に対しましては格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

カーボンニュートラル実現に向け、半導体構造設計技術 SC では、熱設計に関わるシミュレーションモデルの標準化活動を進めてきました。本セミナーでは、ヒートパイプ、ベイパーチャンバーといった高性能放熱機構について特別講演でお話頂くとともに、半導体構造設計技術 SC/熱設計技術 WG における熱設計に関する取り組みを紹介いたします。半導体構造設計技術 SC としての開催は、今回が初めてであり、新組織についても紹介いたします。この機会に是非ご参加頂き、各社の事業戦略・標準化戦略の立案に役立てて頂くと共に、ご興味があれば、同 SC への参画もご検討頂ければ幸いです。

敬具

#### 【開催概要】

日 時 : 2023 年 3 月 29 日 (水) 13:30 ~ 17:10

開催方法 : Webex によるリモート開催

主 催 : (一社) 電子情報技術産業協会

半導体標準化専門委員会/半導体システムソリューション技術委員会/熱設計  
技術 WG

参加費 : 無料

申込方法 : 下記サイトよりお申し込み下さい。お申し込み後、登録頂いたメールアドレス宛に配信する Webex 参加用のミーティングリンクよりご参加下さい。

<https://www.jeita.or.jp/form/custom/257/form>

申込期限 : 2023 年 3 月 22 日 (水) まで

プログラム :

時間	内容
13 : 30 ~ 13 : 35	<b>開会挨拶・趣旨説明</b> JEITA/熱設計技術 WG 主査 西 剛伺 [足利大学]
13 : 35 ~ 13 : 50	<b>半導体構造設計技術 SC の活動紹介</b> JEITA/半導体構造設計技術 SC 主査 吉田 浩芳 [ヌヴォトンテクノロジージャパン (株)]
13 : 50 ~ 14 : 40	<b>特別講演 1 :</b> <b>幅広い製品に浸透しつつあるヒートパイプとベーパーチャンバーの使い方</b> 柴田 博一 様 [(株) ザズーデザイン]
14 : 40 ~ 15 : 25	<b>熱設計技術 WG 活動紹介 1 (WG で推進する熱モデル概要, DXRC, JTAM)</b> JEITA/熱設計技術 WG 主査 西 剛伺 [足利大学] JEITA/熱設計技術 WG 委員 篠田 卓也 [(株) デンソー] JEITA/熱設計技術 WG 委員 熊野 豊 [パナソニック (株)]
15 : 25 ~ 15 : 40	休憩
15 : 40 ~ 16 : 30	<b>特別講演 2 :</b> <b>粉末冶金をウィックとしたループヒートパイプの開発</b> 貞方 和紀 様 [ポーライト (株)]
16 : 30 ~ 17 : 00	<b>熱設計技術 WG 活動紹介 2 (WG で推進する熱伝導率測定, 国際標準化活動)</b> JEITA/熱設計技術 WG 委員・国プロ 委員長 羽鳥 仁人 [(株) ベテル]
17 : 00 ~ 17 : 10	<b>開会挨拶</b> JEITA/熱設計技術 WG 主査 西 剛伺 [足利大学]

※プログラムは都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください。

■運営事務局・各種お問合せ先

一般社団法人 電子情報技術産業協会

事業戦略本部 事業推進部 担当 : 中崎

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1 丁目 1 番 3 号 大手センタービル 4 階

E-mail : [y-nakazaki@jeita.or.jp](mailto:y-nakazaki@jeita.or.jp)

■個人情報保護について

※ご参加いただきました方の個人情報は、本セミナーの受付、JEITA 主催セミナーのご案内、セミナーアンケートでの質疑回答のために使用いたします。これら以外の目的で使用することはございません。

※JEITA の個人情報保護方針につきましては下記をご参照ください。

<http://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>